



高耐热性
MOT 160°C

丰富的薄膜厚度和铜箔厚度产品线

优异的尺寸稳定性

应用
航空航天/工业设备/车载设备

移动设备(智能手机、平板电脑)、医疗设备、工业设备、航空设备、车载电缆(替代线束)等

两面覆铜

R-F775

单面覆铜

R-F770

挠性基板材料

多样的厚度产品线可广泛应用于移动设备等各种用途。

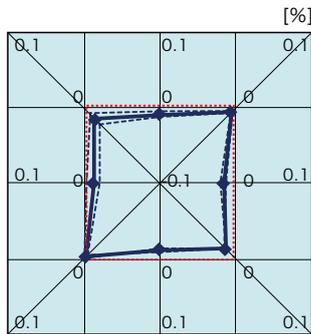
耐热性、尺寸稳定性和质量优异。

低气体释放, 适用于航空航天用途。(符合 ASTM E-595 标准)

尺寸精度

蚀刻后的尺寸变化

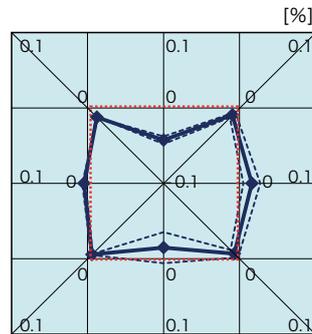
Panasonic Industry
FCCL materials
R-F775 After etching



评估材料为R18-100-R18, 厚度为4mil。

Comparative material

After etching



上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

产品规格

适用于各种薄膜、铜箔的组合 滚切式 最大610mm(MD)×500mm(TD) 滚筒式 W=250mm, 500mm

铜箔厚度		薄膜厚度						单位: mils(mm)
		0.5 (0.013)	1.0 (0.025)	2.0 (0.050)	3.0 (0.075)	4.0 (0.100)	5.0 (0.125)	6.0 (0.150)
压延铜箔	1/4oz (9μm)	●*1	●*1	●*1	—	—	—	●*1
	1/3oz (12μm)	●	●	●	●	●	—	—
	1/2oz (18μm)	●	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●
	1oz (35μm)	●*1	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●
	2oz (70μm)	—	●*2	●*2	●	●	●	—
	3oz (105μm)	—	●	●	—	—	—	—
电解铜箔	- (2μm)	●	●	●	●	—	—	—
	1/6oz (6μm)	●	●	●	—	—	—	—
	1/4oz (9μm)	●	●	●	●	●	●	●
	1/3oz (12μm)	●	●	●	●	●	●	●
	1/2oz (18μm)	●	●	●	●	●	—	—
	1oz (35μm)	—	●	●	●	●	—	—

*1 特殊规格另行协商。 *2 W=610mm另行协商。
本公司的无卤素材料基于的是JPCA-ES-01-2003等的定义。

一般特性

项目		试验方法	条件	单位	FELIOS R-F775	
焊锡耐热性		IPC-TM-650	A	°C	280	
			C-96/40/90		240	
弹性模量		ASTM D882	A	GPa	7.5	
铜箔剥离强度	RA: 1/2oz(18μm)	IPC-TM-650	A	N/mm	>1.4	
热膨胀系数		TMA	100°C→250°C 5°C/分钟	ppm/°C	20	
					MD	18
尺寸稳定性		IPC-TM-650	蚀刻后 MD方向	%	0.00±0.10	
			蚀刻后 TD方向		0.00±0.10	
排气		ASTM E595-07 ASTM E595-15	—	%	0.62	
					TML*	0.001
					CVCM*	0.51
					0.001	
					0.51	

试验片厚度为薄膜层50μm, 铜箔18μm

* TML: Total Mass Loss

CVCM: Collected Volatile Condensable Material

WVR: Water Vapor Recovered

本公司的无卤素材料基于的是JPCA-ES-01-2003等的定义。
上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

[在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。](#)

industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials

松下电器机电 R-F775



松下电器机电 (中国) 有限公司

© Panasonic Industry (China) Co., Ltd. 202508